

QP-613A 型内圆切片机

该机主要用于半导体材料、玻璃、陶瓷、钽酸锂、铌酸锂等脆硬材料的切割。

主要技术特点：

- 采用精密滚动轴承的立式主轴结构，具有主轴刚度大、精度高、寿命长、不易振动的特点。
- 工作台采用精密直线导轨，交流伺服系统，调速范围宽，低速性好，可满足不同材料切割要求，拓宽了适用范围。
- 送料系统采用步进电机及驱动模块，系统稳定，精度高。
- 采用 PLC 可编程控制器，控制简洁可靠，易于维护。
- 采用彩色触摸屏，人机界面美观，操作灵活，便于人性化管理。

主要技术指标：

- 切割晶棒最大直径：153mm
- 刀片规格：690mm×241mm×0.15mm 或 690mm×235mm×0.15mm
- 切割晶棒最大长度：400mm
- 切割进给速度：0.2~120mm/min
- 切割返回速度：1~1000mm/min
- 主轴转速：1420r/min
- 送料进给步距偏差：±0.005mm（按 1mm 当量进给）
- 片厚设定范围：0.001~68.000mm
片厚设定分辨率：0.001mm
- 晶向调节
水平方向(X)±7°（分辨率 2'）
垂直方向(Y)±7°（分辨率 2'）
- 功耗：3.5kW，~ 380V±38V，50Hz±1 Hz
- 空气源：0.4~0.5MPa；250L/min（刹车瞬时）
- 冷却水源：0.2~0.4MPa；5L/min
- 触摸屏：7.7 英寸
- 外形尺寸：1645mm×925mm×2820mm
- 重量：2500kg

